

令和3年度

京都実装技術研究会 第3回例会

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第3回例会として、故障解析、はんだフロー工法の分野から専門の講師の方をお招きしてご講演頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。

- ◇ 開催日時 令和3年10月7日(木) 13:30 ~ 17:00
- ◇ 開催方式 Web/会場参加 併用 (講師はWebでのご講演です)
- ◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)

◇ 内 容

①「実装に関わる評価と関連分析手法の紹介」

株式会社東レリサーチセンター

材料物性研究部 主任研究員 遠藤 亮 氏

構造化学研究部 研究員 内田 智之 氏

形態科学研究部 研究員 安田 光伸 氏

研究開発や生産分野における様々な課題に対して、分析技術や物性解析による技術支援を行っている東レリサーチセンター様より、①「半導体実装関連材料の熱特性評価」②「分光学的手法を用いたパワーデバイスパッケージ品の応力評価」③「電子線回折を用いた結晶方位・配向性の評価」の3つのテーマで実装に関わる評価と分析手法についてご講演頂きます。

②「表面実装部品のはんだフロー工法の紹介」

サンコーデータム株式会社

会長 漆島 将之 氏

実装プリント基板の設計・製造をされているサンコーデータム様より、「表面実装部品のはんだフロー工法の紹介」と題してご講演頂きます。時代とともに微細・高密度化が進む実装分野ですが、フローにおける代表的な部品から設計検証、具体的事例などを交えながらご解説頂きます。

- ◇ 定 員 Web：応募状況により調整 会場：若干名
- ◇ 参加費 会員：無料 非会員：10,000円
(研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。年会費20,000円/社)
- ◇ 申込締切 令和3年10月4日(月)まで
- ◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
(京都実装技術研究会事務局)
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和3年度 京都実装技術研究会 第3回例会申込書

会社名		
所在地		
連絡担当者	所属・役職	
	氏名	
	E-mail	
	電話番号	
参加者	所属・役職	氏名
参加方法	<input type="checkbox"/> Web 参加 <input type="checkbox"/> 会場参加	

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1事業所1接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は、マスクの着用と丁寧な手洗い・手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。